

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(于香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

新聞稿

二零二三年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2023年11月9日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科创板證券代碼：688347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二三年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零二三年第三季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 5.685 億美元，同比下降 9.7%，環比下降 10.0%。
- 毛利率 16.1%，同比下降 21.1 個百分點，環比下降 11.6 個百分點。
- 母公司擁有人應佔溢利 1,390 萬美元，上年同期為 1.039 億美元，上季度為 7,850 萬美元。
- 基本每股盈利 0.009 美元，上年同期為 0.080 美元，上季度為 0.060 美元。
- 淨資產收益率（年化）1.2%，上年同期為 14.4%，上季度為 10.0%。

二零二三年第四季度指引

- 我們預計銷售收入約在 4.5 億美元至 5.0 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 2% 至 5% 之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對二零二三年第三季度業績評論道：

“當前宏觀環境複雜多變，半導體行情尚未復蘇。華虹半導體在艱巨挑戰中砥礪前行，於二零二三年第三季度實現了 5.685 億美元營收，當季毛利率為 16.1%，符合指引預期。隨著華虹無錫 12 英寸生產線項目產能爬坡，截至第三季度末，公司折合八英寸月產能增加到了 35.8 萬片。在具備了更大規模生產能力的同時，也為新產品的研發上線提供了更強勁的支持。憑藉多年來在特色工藝領域的技術積累和多元化工藝平臺優勢，公司的各項產品，尤其是 IGBT 和超級結，在新能源、汽車電子等領域持續發力，獲得了客戶的高度認可。”

唐總繼續講道：“公司的第二條 12 英寸生產線--華虹無錫製造項目，正在緊鑼密鼓地推進中。目前，該項目處於廠房建設階段，預計將於 2024 年底前建成投片，並在隨後的三年內逐步形成 8.3 萬片的月產能，為公司的中長期發展打下堅實基礎。即使市場低迷，公司依然注重研發投入和團隊建設，持續提高產品品質和各項性能指標，進一步夯實特色工藝晶圓代工龍頭地位，以更出色的業績回饋投資人。”

電話會議公告

- 日期 2023 年 11 月 9 日（星期四）
- 時間： 17:00 香港/上海時間
04:00 美國東部時間
- 發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官
- 廣播： 會議將在 http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/a6md2c9y> 作線上直播
(請提前註冊登記)
- 電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN（個人身份識別碼）。

<https://register.vevent.com/register/Blcd83b51831f1463db11bdea840a69615>

重要提示： 在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN（個人身份識別碼）才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN（個人身份識別碼）。
- 網上重播： 直播約 12 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（A 股簡稱：華虹公司，688347；港股簡稱：華虹半導體，01347）（“本公司”）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先進“特色 IC + Power Discrete”的發展戰略，為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等“8 英寸 + 12 英寸”特色工藝技術的持續創新，有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是中國擁有“8 英寸 + 12 英寸”先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片。另在無錫高新技術產業開發區內建有一座月產能 8.0 萬片的 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），這不僅是全球領先的 12 英寸特色工藝生產線，也是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。目前，本公司正在推進華虹無錫二期 12 英寸芯片生產線（華虹九廠）的建設。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	568,529	629,907	631,381	(9.7)%	(10.0)%
毛利	91,623	234,056	175,056	(60.9)%	(47.7)%
毛利率	16.1%	37.2 %	27.7 %	(21.1)	(11.6)
經營開支	(85,065)	(73,611)	(76,668)	15.6 %	11.0 %
其他損失淨額	(19,417)	(57,825)	(54,709)	(66.4)%	(64.5)%
稅前(損失)/溢利	(12,859)	102,620	43,679	(112.5)%	(129.4)%
所得稅開支	(12,999)	(37,174)	(35,845)	(65.0)%	(63.7)%
期內(損失)/溢利	(25,858)	65,446	7,834	(139.5)%	(430.1)%
淨利潤率	(4.5)%	10.4 %	1.2 %	(14.9)	(5.7)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	13,890	103,899	78,524	(86.6)%	(82.3)%
非控股權益	(39,748)	(38,453)	(70,690)	3.4 %	(43.8)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.009	0.080	0.060	(88.8)%	(85.0)%
攤薄	0.009	0.079	0.060	(88.6)%	(85.0)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,077	1,003	1,074	7.4 %	0.3 %
產能利用率 ¹	86.8 %	110.8 %	102.7 %	(24.0)	(15.9)
淨資產收益率 ²	1.2 %	14.4 %	10.0 %	(13.2)	(8.8)

二零二三年第三季度

- 銷售收入 5.685 億美元，同比下降 9.7%，環比下降 10.0%，主要由於平均銷售價格下降。
- 毛利率 16.1%，同比下降 21.1 個百分點，環比下降 11.6 個百分點，主要由於平均銷售價格下降及產能利用率降低。
- 經營開支 8,510 萬美元，同比上升 15.6%，環比上升 11.0%，主要由於工程片開支增加。
- 其他損失淨額 1,940 萬美元，同比下降 66.4%，環比下降 64.5%，主要由於外幣匯兌損失下降，部分被政府補貼減少所抵消。
- 所得稅開支 1,300 萬美元，同比下降 65.0%，環比下降 63.7%，主要由於應課稅利潤下降。
- 期內損失 2,590 萬美元，上年同期為期內溢利 6,540 萬美元，上季度為期內溢利 780 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 1,390 萬美元，上年同期為 1.039 億美元，上季度為 7,850 萬美元。
- 基本每股盈利 0.009 美元，上年同期為 0.080 美元，上季度為 0.060 美元。
- 淨資產收益率（年化）1.2%，上年同期為 14.4%，上季度為 10.0%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	二零二二年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	538,547	94.7 %	598,553	95.0 %	(60,006)	(10.0)%
其他	29,982	5.3 %	31,354	5.0 %	(1,372)	(4.4)%
銷售收入總額	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度 94.7% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	二零二二年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	298,615	52.5 %	384,235	61.0 %	(85,620)	(22.3)%
12 吋晶圓	269,914	47.5 %	245,672	39.0 %	24,242	9.9 %
銷售收入總額	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.986 億美元及 2.699 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	二零二二年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	441,246	77.5 %	452,306	71.8 %	(11,060)	(2.4)%
北美 ⁴	48,764	8.6 %	80,450	12.8 %	(31,686)	(39.4)%
歐洲	38,976	6.9 %	30,340	4.8 %	8,636	28.5 %
亞洲 ⁵	34,663	6.1 %	55,733	8.8 %	(21,070)	(37.8)%
日本 ⁶	4,880	0.9 %	11,078	1.8 %	(6,198)	(55.9)%
銷售收入總額	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.412 億美元，占銷售收入總額的 77.5%，同比下降 2.4%，主要由於 MCU、智能卡芯片和其他電源管理產品需求減少，部分被 IGBT、模擬及超級結產品需求增加所抵消。
- 本季度來自於北美的銷售收入 4,880 萬美元，同比下降 39.4%，主要由於其他電源管理及 MCU 產品的需求減少。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 3,900 萬美元，同比增長 28.5%，主要得益於 IGBT 和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 3,470 萬美元，同比下降 37.8%，主要由於 MCU 及邏輯產品的需求減少。
- 本季度來自於日本的銷售收入 490 萬美元，同比下降 55.9%，主要由於 MCU 產品的需求減少。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵不包括中國及日本。

⁶包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	二零二二年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	143,629	25.3 %	213,813	33.9 %	(70,184)	(32.8)%
獨立式非易失性存儲器	36,800	6.5 %	43,473	6.9 %	(6,673)	(15.3)%
分立器件	235,978	41.5 %	191,391	30.4 %	44,587	23.3 %
邏輯及射頻	49,878	8.8 %	59,069	9.4 %	(9,191)	(15.6)%
模擬與電源管理	100,897	17.7 %	121,777	19.3 %	(20,880)	(17.1)%
其他	1,347	0.2 %	384	0.1 %	963	250.8 %
銷售收入總額	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.436 億美元，同比下降 32.8%，主要由於 MCU 及智能卡芯片的需求減少。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 3,680 萬美元，同比下降 15.3%，主要由於 NOR flash 產品的需求減少。
- 本季度分立器件銷售收入 2.360 億美元，同比增長 23.3%，主要得益於 IGBT 及超級結產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 4,990 萬美元，同比下降 15.6%，主要由於邏輯產品的需求減少。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.009 億美元，同比下降 17.1%，主要由於其他電源管理產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	二零二二年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	87,329	15.4 %	78,566	12.5 %	8,763	11.2 %
90nm 及 95nm	87,616	15.4 %	141,726	22.5 %	(54,110)	(38.2)%
0.11 μ m 及 0.13 μ m	82,990	14.6 %	113,063	17.9 %	(30,073)	(26.6)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	34,993	6.2 %	54,590	8.7 %	(19,597)	(35.9)%
0.25 μ m	8,395	1.5 %	3,471	0.6 %	4,924	141.9 %
0.35 μ m 及以上	267,206	46.9 %	238,491	37.8 %	28,715	12.0 %
銷售收入總額	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 8,730 萬美元，同比增長 11.2%，主要得益於模擬及其他電源管理產品需求增加，部分被邏輯及 NOR flash 產品的需求減少所抵消。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 8,760 萬美元，同比下降 38.2%，主要由於其他電源管理、智能卡芯片及 MCU 產品的需求減少。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 8,300 萬美元，同比下降 26.6%，主要由於 MCU 產品的需求減少。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,500 萬美元，同比下降 35.9%，主要由於 MCU 及邏輯產品的需求減少。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 840 萬美元，同比上升 141.9%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.672 億美元，同比增長 12.0%，主要得益於 IGBT 及超級結產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	二零二二年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	325,224	57.2 %	408,328	64.9 %	(83,104)	(20.4)%
工業及汽車	159,380	28.0 %	148,889	23.6 %	10,491	7.0 %
通訊	71,662	12.6 %	54,138	8.6 %	17,524	32.4 %
計算機	12,263	2.2 %	18,552	2.9 %	(6,289)	(33.9)%
銷售收入總額	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 3.252 億美元，占銷售收入總額的 57.2%，同比下降 20.4%，主要由於 MCU、其他電源管理及智能卡芯片的需求減少，部分被超級結產品的需求增加所抵消。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.594 億美元，同比增長 7.0%，主要得益於 IGBT 產品需求增加，部分被 MCU 及智能卡芯片需求減少所抵消。
- 本季度通訊產品銷售收入 7,170 萬美元，同比增長 32.4%，主要得益於模擬產品需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,230 萬美元，同比下降 33.9%，主要由於通用 MOSFET 及 MCU 產品需求減少。

產能⁷及產能利用率

晶圓廠(折合 8 吋片晶圓)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)
產能 (200mm)	178	178	178
產能 (300mm)	80	65	75
合計產能	358	324	347
產能利用率 (200mm)	95.3%	113.4%	112.0%
產能利用率 (300mm)	78.4%	107.7%	92.9%
總體產能利用率	86.8%	110.8%	102.7%

- 本季度末月產能 358,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 86.8%。

⁷ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,077	1,003	1,074	7.4 %	0.3 %

- 本季度付運晶圓 1,077,000 片，同比上升 7.4%，環比持平。

經營開支分析

以仟美元計	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,415	2,524	2,402	(4.3)%	0.5 %
管理費用 ⁸	82,650	71,087	74,266	16.3 %	11.3 %
經營開支	85,065	73,611	76,668	15.6 %	11.0 %

- 經營開支 8,510 萬美元，同比上升 15.6%，環比上升 11.0%，主要由於工程片開支增加。

其他損失淨額

以仟美元計	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,428	3,372	3,921	1.7 %	(12.6)%
利息收入	15,742	7,054	14,057	123.2 %	12.0 %
匯兌損失	(13,986)	(79,444)	(62,646)	(82.4)%	(77.7)%
分佔聯營公司(損失)/溢利	(1,410)	2,561	1,984	(155.1)%	(171.1)%
財務費用	(24,257)	(16,886)	(28,287)	43.7 %	(14.2)%
政府補貼	77	24,663	14,213	(99.7)%	(99.5)%
其他	989	855	2,049	15.7 %	(51.7)%
其他損失淨額	(19,417)	(57,825)	(54,709)	(66.4)%	(64.5)%

- 其他損失淨額 1,940 萬美元，同比下降 66.4%，環比下降 64.5%，主要由於外幣匯兌損失下降，部分被政府補貼減少所抵消。

⁸管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以仟美元計	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	152,091	158,604	161,190	(4.1)%	(5.6)%
投資活動所用現金流量淨額	(177,466)	(399,962)	(150,649)	(55.6)%	17.8 %
融資活動所得/(用)現金流量淨額	3,176,383	579,684	(300,183)	448.0 %	(1,158.1)%
外匯匯率變動影響淨額	(12,464)	(61,748)	(77,948)	(79.8)%	(84.0)%
現金及現金等價物變動影響淨額	3,138,544	276,578	(367,590)	1,034.8 %	(953.8)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.521 億美元，同比下降 4.1%，主要由於政府補貼減少，部分被支付的貸款減少所抵消，環比下降 5.6%，主要由于政府補貼減少及人員開支增加，部分被支付所得稅減少所抵消。
- 投資活動所用現金流量淨額 1.775 億美元，其中包括固定資產及無形資產投資支出 1.937 億美元，部分被收到利息收入 1,620 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 31.764 億美元，其中包括 A 股科創板發行股份募集資金 29.370 億美元，提取銀行借款 3.477 億美元，質押保證金減少 1.365 億美元，員工行權發行股份收到 70 萬美元，部分被償還銀行借款 2.391 億美元，支付利息 380 萬美元，支付上市費用 140 萬美元及支付租賃負債 120 萬美元所抵消。

資本結構

以仟美元計	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)
資產總額	9,974,339	6,950,336
負債總額	2,642,094	2,555,160
所有者權益總額	7,332,245	4,395,176
資產負債率 ⁹	26.5%	36.8%

資本開支

以仟美元計	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)
華虹 8 吋	22,795	16,677
華虹無錫	111,827	148,289
華虹製造	59,030	-
合計	193,652	164,966

- 本季度資本開支 1.937 億美元，其中 1.118 億美元用於華虹無錫，5,900 萬美元用於華虹製造。

⁹資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以仟美元計	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)
發展中物業	157,230	143,674
存貨	492,783	558,252
貿易應收款項及應收票據	318,787	310,705
預付款項、其他應收款項及其他資產	34,168	32,194
應收關聯方款項	19,572	16,803
已凍結存款及定期存款	31,654	167,077
現金及現金等價物	4,989,501	1,850,957
流動資產總額	6,043,695	3,079,662
貿易應付款項	213,530	227,907
其他應付款項及暫估費用	357,181	397,826
計息銀行借款	180,238	385,746
租賃負債	3,281	4,477
政府補助	34,321	34,133
應付關聯方款項	4,604	4,720
應付所得稅	57,885	49,557
流動負債總額	851,040	1,104,366
淨營運資金	5,192,655	1,975,296
速動比率	6.3x	2.2x
流動比率	7.1x	2.8x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	50	45
存貨周轉天數	99	114

- 存貨由上季度末的 5.583 億美元下降至本季度末的 4.928 億美元，主要由於產成品及在製品的減少。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 1.671 億美元下降至本季度末的 3,170 萬美元，主要由於銀行借款質押保證金減少。
- 現金及現金等價物由上季度末的 18.510 億美元上升至本季度末的 49.895 億美元，主要由於前述現金流量分析中闡述的原因。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 3.978 億美元下降至本季度末的 3.572 億美元，主要由於應付資產開支減少。
- 計息銀行借款由上季度末的 3.857 億美元下降至本季度末的 1.802 億美元，主要由於償還銀行借款本金。
- 淨營運資金 本季度末 51.927 億美元，流動比率 7.1。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 50 天。
- 存貨周轉天數 99 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)
銷售收入	568,529	629,907	631,381
銷售成本	(476,906)	(395,851)	(456,325)
毛利	91,623	234,056	175,056
其他收入及收益	20,290	35,967	34,245
銷售及分銷費用	(2,415)	(2,524)	(2,402)
管理費用	(82,650)	(71,087)	(74,266)
其他費用	(14,040)	(79,467)	(62,651)
財務費用	(24,257)	(16,886)	(28,287)
分佔聯營公司(損失)/溢利	(1,410)	2,561	1,984
稅前(損失)/溢利	(12,859)	102,620	43,679
所得稅開支	(12,999)	(37,174)	(35,845)
期內(損失)/溢利	(25,858)	65,446	7,834
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	13,890	103,899	78,524
非控股權益	(39,748)	(38,453)	(70,690)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.009	0.080	0.060
攤薄	0.009	0.079	0.060
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,580,159,540	1,303,756,848	1,308,028,146
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,587,083,357	1,311,796,050	1,318,619,081

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以仟美元計)

	截至		
	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	3,322,946	3,256,562	3,140,178
投資物業	164,287	163,241	165,746
使用權資產	79,070	80,145	78,359
無形資產	29,182	31,170	34,447
於聯營公司的投資	128,833	129,414	116,894
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	153,024	151,812	163,182
長期預付款項	36,085	40,937	21,939
遞延稅項資產	17,217	17,393	15,157
非流動資產總額	3,930,644	3,870,674	3,735,902
流動資產			
發展中物業	157,230	143,674	117,971
存貨	492,783	558,252	509,630
貿易應收款項及應收票據	318,787	310,705	240,551
預付款項、其他應收款項及其他資產	34,168	32,194	60,304
應收關聯方款項	19,572	16,803	10,764
已凍結存款及定期存款	31,654	167,077	1,022
現金及現金等價物	4,989,501	1,850,957	1,984,228
流動資產總額	6,043,695	3,079,662	2,924,470
流動負債			
貿易應付款項	213,530	227,907	223,704
其他應付款項及暫估費用	357,181	397,826	621,494
計息銀行借款	180,238	385,746	422,913
租賃負債	3,281	4,477	4,564
政府補助	34,321	34,133	63,274
應付關聯方款項	4,604	4,720	10,265
應付所得稅	57,885	49,557	57,730
流動負債總額	851,040	1,104,366	1,403,944
流動資產淨額	5,192,655	1,975,296	1,520,526
總資產減流動負債	9,123,299	5,845,970	5,256,428
非流動負債			
計息銀行借款	1,745,779	1,410,544	1,355,037
租賃負債	18,650	18,312	14,976
遞延稅項負債	26,625	21,938	26,827
非流動負債總額	1,791,054	1,450,794	1,396,840
淨資產	7,332,245	4,395,176	3,859,588
權益和負債權益			
股本	4,932,673	1,997,829	1,993,604
儲備	1,164,151	1,130,367	808,552
本公司擁有人應佔權益	6,096,824	3,128,196	2,802,156
非控股權益	1,235,421	1,266,980	1,057,432
權益總額	7,332,245	4,395,176	3,859,588

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前(虧損)/溢利	(12,859)	102,620	43,679
折舊及攤銷	127,305	116,426	123,661
應佔聯營公司虧損/(溢利)	1,410	(2,561)	(1,984)
營運資金的變動及其它	36,235	(57,881)	(4,166)
經營活動所得現金流量淨額	152,091	158,604	161,190
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(193,652)	(428,684)	(164,966)
其他投資活動所得現金流量	16,186	28,722	14,317
投資活動所用現金流量淨額	(177,466)	(399,962)	(150,649)
融資活動所得/(用)現金流量：			
非控股權益資本注資	-	392,000	-
提取銀行貸款	347,707	248,768	8,116
發行股份所得收益	2,937,689	2,972	1,407
受限制貨幣資金減少/(增加)	136,524	-	(167,738)
償還銀行貸款	(239,086)	(62,171)	(85,565)
償還租賃負債	(1,230)	(333)	(3,320)
已付利息	(3,803)	(1,552)	(52,720)
其他融資活動所用現金流量	(1,418)	-	(363)
融資活動所得/(用)現金流量淨額	3,176,383	579,684	(300,183)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	3,151,008	338,326	(289,642)
外匯匯率變動影響淨額	(12,464)	(61,748)	(77,948)
期初現金及現金等價物	1,850,957	1,707,650	2,218,547
期末現金及現金等價物	4,989,501	1,984,228	1,850,957

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

孫國棟

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事会命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二三年十一月九日